

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-304770

(43)Date of publication of application : 02.11.2000

(51)Int.Cl. G01R 1/073
G01R 31/26
H01L 21/66

(21)Application number : 11-109977

(71)Applicant : ADVANTEST CORP

(22)Date of filing : 16.04.1999

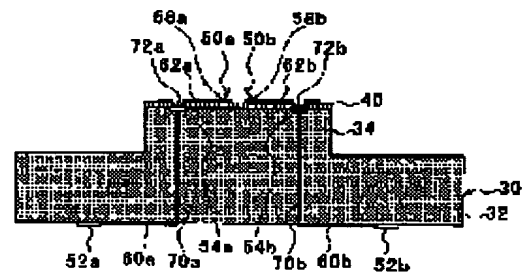
(72)Inventor : KOJIMA AKIO

(54) PROBE CARD AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a probe card enhanced in the precision in needle position, when a probe needle is bonded onto a substrate, enhanced in signal quality by shortening a non-transfer line.

SOLUTION: A printed board 30 comprising a plurality of first transfer lines 60a and 60b, a build-up substrate 40 which is, comprising a plurality of second transfer lines 62a and 62b bonded to the plurality of first transfer lines 60a and 60b, respectively, stacked to the printed board 30, and a plurality of probe needles 50a and 50b which are bonded to the plurality of second transfer lines 62a and 62b, respectively, and brought into contact with each of electrodes of electric part which is to be an object for probe test, are provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2000-304770
(P2000-304770A)

(43)公開日 平成12年11月2日(2000.11.2)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト*(参考)
G 0 1 R 1/073		G 0 1 R 1/073	E 2 G 0 0 3
	31/26	31/26	J 2 G 0 1 1
H 0 1 L 21/66		H 0 1 L 21/66	B 4 M 1 0 6

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平11-109977

(22)出願日 平成11年4月16日(1999.4.16)

(71)出願人 390005175

株式会社アドバンテスト

東京都練馬区旭町1丁目32番1号

(72)発明者 小嶋 昭夫

東京都練馬区旭町1丁目32番1号株式会社
アドバンテスト内

(74)代理人 100104156

弁理士 龍華 明裕

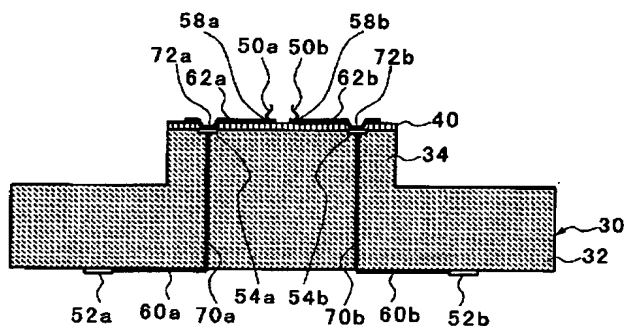
Fターム(参考) 2G003 AA07 AB01 AG03 AG08 AG12
2G011 AA02 AA17 AC14 AE22 AF07
4M106 AA02 BA01 BA14 DD03 DD10
DD11 DD15

(54)【発明の名称】 プローブカード及びプローブカード製造方法

(57)【要約】

【課題】 基板上にプローブ針を接合する際の針位置精度を高め、かつ、非伝送線路の短縮により信号の質を高めたプローブカードを提供する。

【解決手段】 複数の第一伝送線路60a、bを有するプリント基板30と、複数の第一伝送線路60a、bの各々に接合する複数の第二伝送線路62a、bを有し、プリント基板30に重ね合わされるビルドアップ基板40と、複数の第二伝送線路62a、bの各々に接合し、プローブテスト対象となる電気部品の電極の各々に接触させる複数のプローブ針50a、bとを備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気部品の電極に接触し、前記電気部品の特性を試験するために用いられるプローブカードであって、

複数の第一伝送線を有するプリント基板と、

複数の前記第一伝送線の各々に接合する複数の第二伝送線を有し、前記プリント基板に重ね合わされるビルドアップ基板と、

複数の前記第二伝送線の各々に接合し、前記電極の各々に接触させる複数のプローブ針とを備えることを特徴とするプローブカード。

【請求項2】 前記プリント基板は、扁平部と前記扁平部の上面中央に設けられた中央凸部とを有し、前記ビルドアップ基板は前記中央凸部に重ね合わされることを特徴とする請求項1に記載のプローブカード。

【請求項3】 前記ビルドアップ基板は、フィルム状に生成されて前記プリント基板に張着されることを特徴とする請求項1又は2に記載のプローブカード。

【請求項4】 前記ビルドアップ基板はエポキシ基板であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のプローブカード。

【請求項5】 前記プリント基板は、ガラスエポキシ基板であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載のプローブカード。

【請求項6】 複数の前記第二伝送線の最小間隔は、前記第一伝送線の最小間隔よりも小さいことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のプローブカード。

【請求項7】 複数の前記第一伝送線は、各々の両端に複数の第一及び第二パッドを含み、

複数の前記第二伝送線は、各々の一端に複数の第三パッドを含み、

複数の前記第二パッドの各々と複数の前記第二伝送線の各々が接合し、複数の前記第三パッドと複数の前記プローブ針とが接合することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載のプローブカード。

【請求項8】 複数の前記第三パッドのピッチは、複数の前記第二パッドのピッチよりも狭いことを特徴とする請求項7に記載のプローブカード。

【請求項9】 複数の前記第三パッドの間隔は、複数の前記第二パッドの間隔よりも狭いことを特徴とする請求項7又は8に記載のプローブカード。

【請求項10】 複数の前記第二パッドのピッチは、複数の前記第一パッドのピッチよりも狭いことを特徴とする請求項7乃至9のいずれかに記載のプローブカード。

【請求項11】 複数の前記第二パッドの間隔は、複数の前記第一パッドの間隔よりも狭いことを特徴とする請求項7乃至10のいずれかに記載のプローブカード。

【請求項12】 複数の前記プローブ針は、上下方向に弾力性を有し、かつ、複数の前記第三パッドの各々に接

合する一端と前記電極の各々に接触する他端とが水平方向にずれていることを特徴とする請求項7乃至11のいずれかに記載のプローブカード。

【請求項13】 電気部品の特性を試験するために用いられるプローブカードを製造するプローブカード製造方法であって、

第一基板に第一伝送線を設ける段階と、

前記第一基板に第二基板を重ね合わせる段階と、

前記第二基板に第二伝送線を設ける段階と、

前記第一及び第二基板を所定の形状に切断する切断段階と、

前記第二基板の上にプローブ針を形成させるプローブ針形成段階と、を備えることを特徴とするプローブカード製造方法。

【請求項14】 前記第一基板が、扁平部と前記扁平部の上面中央に設けられた中央凸部と、前記中央凸部から所定の距離を隔てて前記扁平部の上面外周側に設けられた外周凸部とを有し、

前記切断段階は、前記中央凸部の外周に沿って前記第二基板を切断する段階と、前記外周凸部の内周に沿って前記第一基板を切断する段階とを有することを特徴とする請求項13に記載のプローブカード製造方法。

【請求項15】 前記プローブ針形成段階は、前記プローブ針を複数同時に形成させる段階を有することを特徴とする請求項13又は14に記載のプローブカード製造方法。

【請求項16】 前記プローブ針形成段階は、基板上にワイヤを固着するボンディングマシンによって前記ワイヤの先端部を前記第二基板上に固着する段階と、前記ワイヤにおける前記先端部より上部を加熱して切り取る段階とを有することを特徴とする請求項13乃至15のいずれかに記載のプローブカード製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ICチップ、LSIチップ等の電気部品の電気的特性を試験するプローブカードに関する。特に本発明は、プローブ針の位置精度と信号の質とを高めたプローブカードに関する。

【0002】

【従来の技術】図1は、従来のプローブカードの断面図である。図に示される通り、従来のプローブカードは、プリント基板10と複数のプローブ針20（20a、b）と複数の半田付け部24（24a、b）と複数の固定用樹脂部26（26a、b）と複数の固定台28（28a、b）とを備える。プリント基板10は、複数の伝送線路22（22a、b）を有する。プローブカードは、ICチップ、LSIチップ等の電気部品の電気的特性試験（プローブテスト）を行うために用いられる。

【0003】プローブ針20は、片持状に支持されるカンチレバー型である。複数のプローブ針20a、bは、

断面三角形状の複数の固定台28a、bに斜めに支持され、手で位置を微調整した後、複数の固定用樹脂部26a、bにより固定される。複数のプローブ針20a、bの各々と複数の伝送線路22a、bの各々とは複数の半田付け部24a、bにより接合される。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】プリント基板10として、例えばガラスエポキシ基板等の位置精度の低い基板を用いた場合、プローブ針20を接合する際に手で位置を微調整しなければならないという問題があった。また、位置精度の低い基板の場合、複数のプローブ針20a、bのピッチ及び間隔を狭くすることが困難であった。

【0005】そこで本発明は、上記の課題を解決することのできるプローブカード及びその製造方法を提供することを目的とする。この目的は特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項は本発明のさらなる有利な具体例を規定する。

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明の第1の形態においては、電気部品の電極に接触し、前記電気部品の特性を試験するために用いられるプローブカードであって、複数の第一伝送線路を有するプリント基板と、複数の前記第一伝送線路の各々に接合する複数の第二伝送線路を有し、前記プリント基板に重ね合わされるビルドアップ基板と、複数の前記第二伝送線路の各々に接合し、前記電極の各々に接触させる複数のプローブ針とを備える。

【0006】前記プリント基板は、扁平部と前記扁平部の上面中央に設けられた中央凸部とを有し、前記ビルドアップ基板は前記中央凸部上に重ね合わされてもよい。前記ビルドアップ基板は、フィルム状に生成されて前記プリント基板に張着されてもよい。前記ビルドアップ基板はエポキシ基板であってもよく、前記プリント基板は、ガラスエポキシ基板であってもよい。

【0007】複数の前記第二伝送線路の最小間隔は、前記第一伝送線路の最小間隔よりも小さくてもよい。複数の前記第一伝送線路は、各々の両端に複数の第一及び第二パッドを含み、複数の前記第二伝送線路は、各々の一端に複数の第三パッドを含み、複数の前記第二パッドの各々と複数の前記第二伝送線路の各々とが接合し、複数の前記第三パッドと複数の前記プローブ針とが接合してもよい。複数の前記第三パッドのピッチは、複数の前記第二パッドのピッチよりも狭く、複数の前記第三パッドの間隔は、複数の前記第二パッドの間隔よりも狭くてもよい。複数の前記第二パッドのピッチは、複数の前記第一パッドのピッチよりも狭く、複数の前記第二パッドの間隔は、複数の前記第一パッドの間隔よりも狭くてもよい。

【0008】複数の前記プローブ針は、上下方向に弾力性を有し、かつ、複数の前記第三パッドの各々に接合す

る一端と前記電極の各々に接触する他端とが水平方向にずれていてもよい。

【0009】本発明の第2の形態においては、電気部品の特性を試験するために用いられるプローブカードを製造するプローブカード製造方法であって、第一基板に第一伝送線路を設ける段階と、前記第一基板に第二基板を重ね合わせる段階と、前記第二基板に第二伝送線路を設ける段階と、前記第一及び第二基板を所定の形状に切断する切断段階と、前記第二基板の上にプローブ針を形成させるプローブ針形成段階とを備える。

【0010】前記第一基板が、扁平部と前記扁平部の上面中央に設けられた中央凸部と、前記中央凸部から所定の距離を隔てて前記扁平部の上面外周側に設けられた外周凸部とを有し、前記切断段階は、前記中央凸部の外周に沿って前記第二基板を切断する段階と、前記外周凸部の内周に沿って前記第一基板を切断する段階とを有してもよい。前記プローブ針形成段階は、前記プローブ針を複数同時に形成させる段階を有してもよい。前記プローブ針形成段階は、基板上にワイヤを固着するボンディングマシンによって前記ワイヤの先端部を前記第二基板上に固着する段階と、前記ワイヤにおける前記先端部より上部を加熱して切り取る段階とを有してもよい。

【0011】なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた発明となりうる。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。

【0013】まず、第1の実施形態について以下説明する。図2は、第1の実施形態のプローブカードを示す断面図である。図に示す通り、本実施形態のプローブカードは、プリント基板30とビルドアップ基板40と複数のプローブ針50（50a、b）とを備える。プローブカードは、ICチップ、LSIチップ等の電気部品の電気的特性試験（プローブテスト）を行うために用いられる。

【0014】プリント基板30はガラスエポキシ積層基板であり、扁平部32と扁平部32の中央上面に設けられた中央凸部34とを有する。ビルドアップ基板40はフィルム状のエポキシ基板であり、プリント基板30の中央凸部34上面に張着される。本実施形態では、接着剤を用いて張着している。プリント基板30は、硬質で表面の平坦度が高く、また、たわみに耐えられる十分な機械的強度と十分な厚みとを有する。ビルドアップ基板40は、フィルム状で柔らかく、平坦度と機械的強度とが低いが、プリント基板30の上面に張着することにより平坦度と機械的強度とが高まる。ビルドアップ基板4

0は、エポキシ層とエポキシ層の上面に設けられた配線層とを有する。複数の配線層を設けてビルドアップ基板40を多層構造としてもよい。例えば、エポキシ材を2枚重ねてビルドアップ基板40の配線層を2層としてもよい。

【0015】複数の第一伝送線路60a、bは、プリント基板30に設けられる。複数の第一伝送線路60a、bは、プリント基板30の下面に設けられる部分と、プリント基板30の所定位置に設けられる複数のスルーホール70a、bとを含む。複数の第一伝送線路60a、bの各々の一端には、プリント基板30の下面で複数の第一パッド52a、bが設けられる。複数の第一伝送線路60a、bの各々の他端には、プリント基板30の上面で複数の第二パッド54a、bが設けられる。

【0016】複数の第二伝送線路62a、bは、ビルドアップ基板40の上面に設けられる。複数の第二伝送線路62a、bの各々の一端には、第三パッド58a、bが設けられる。グランド線は複数の第二伝送線路62a、bの近傍に設けられる。

【0017】複数の第二伝送線路62a、bは、エポキシ層を貫通する微小孔の内側面及び開口底面にメッキして形成する複数の第一ビア(Via)72a、bを有する。複数の第一ビア72a、bの各々は、下方に窪んだ形状を有し、下方に位置する複数の第二パッド54a、bに接合する。これにより、複数の第二伝送線路62a、bは、複数の第一ビア72a、bを通じて複数の第二パッド54a、bに接合される。第一、第二及び第三パッド52、54、58の表面は、Au(金)等の接触抵抗の低い金属でメッキされている。但し、他の形態としては、Auにより別途パッドを設けて第一及び第二伝送線路60、62に接合する構成としてもよい。

【0018】複数のプローブ針50a、bの各々は、複数の第三パッド58a、bの各々の上に形成される。本実施形態における複数のプローブ針50a、bは、S字の形状を有し、複数の第三パッド58a、bの上に固着される。プローブ針50の長さは約2mmと微小である。S字形状の微小針は、湾曲部により上下方向の弾力が得られる。また、S字形状の微小針は、第三パッド58に接合する一端と電気部品の電極に接触する他端とが水平方向にずれている。従って、電気部品の電極により下方向に押圧されると、微小針の両端が水平方向にさらにずれ、接触する電気部品の電極をスクラブする(こす)ることとなる。このようにS字形状の微小針は電極への接触性が高い。複数のプローブ針50a、bとしては、S字形状の微小針以外に、片持状のカンチレバー式の針、円錐状のバンプ等の様々な種類の針を用いることができる。

【0019】本実施形態においては、複数のプローブ針50a、bとして微小針を用いるので、非伝送線路の長さを短くでき、信号の信頼性を高めることができる。例

えば、微小針の長さが約2mmの場合、数GHzの信号を通過させることができる。また、複数のプローブ針50a、bとして微小針を用いるので、プリント基板30に設けられるコンデンサからプローブテスト対象の電気部品までの距離を短縮することができ、電源ノイズを減少させることができる。

【0020】図3は、プローブカードの平面図である。プリント基板30の中央凸部の上面に張着されたビルドアップ基板40の上面において、複数の第二伝送線路62が設けられる。複数のプローブ針50及び複数の第三パッド58は、プローブテスト対象となる電気部品の電極に対応する位置に設けられる。

【0021】複数の第二伝送線路62の各々は、ビルドアップ基板40の上面において第三パッド58の各々から外側方向へ放射状に広がり、外側の一端に複数の第一ビア72が設けられる。第三パッド58のピッチは、複数の第二パッド54のピッチより狭い。複数の第三パッド58の間隔(パッド端間隔d1)は、複数の第二パッド54(パッド端間隔d2)の間隔より狭い。

【0022】プリント基板30には、複数の第一伝送線路60が設けられる。複数の第二パッド54の各々は、複数の第一ビア72の各々に接合する。複数の第一伝送線路60は、複数の第二パッド54から図示しない複数のスルーホールを経てプリント基板30の下面へ通ずる。そして、複数の第一伝送線路60は、プリント基板30の下面において、複数の第一パッド52まで外側方向へ放射状に広がる。

【0023】複数のスルーホールの各々は、複数の第二パッド54の各々の下方に位置する。複数の第二パッド54のピッチは、複数の第一パッド52のピッチより狭い。複数の第二パッド54の間隔(パッド端間隔d2)は、複数の第一パッド52の間隔(パッド端間隔d3)より狭い。プリント基板30が積層基板である場合、複数の第一伝送線路60を積層された基板中の一層に設け、外側方向へ放射状に広げてもよい。

【0024】本実施形態によれば、プリント基板30の上面にビルドアップ基板40を設けているので、ビルドアップ基板40上に設ける第三パッド58の位置精度を高くすることができる。これにより、プローブ針50を所望の位置に形成することができる。ビルドアップ基板40として、例えばセラミック基板を用いることもでき、その場合もビルドアップ基板40上の第三パッド58及びプローブ針50の位置精度を高めることができる。エポキシ基板は安価であるため、高価なセラミック基板よりも低コストで基板上の位置精度を高められる。

【0025】本実施形態によれば、ビルドアップ基板40の上面において高い位置精度で複数の第三パッド58及び複数のプローブ針50を設けられる。従って、複数の第三パッド58の間隔及びピッチ、並びに、複数のプローブ針50の間隔及びピッチを極小にすることができ

る。本実施形態においては、複数のプローブ針50のピッチは約80 μ mである。

【0026】次に、第2の実施形態について説明する。第2の実施形態は、ビルドアップ基板40が2枚のエポキシ材を重ね合わせて形成される点を除き、第1の実施形態とほぼ同様である。図4は、第2の実施形態におけるプローブカードの断面図である。

【0027】プローブテスト対象となる電気部品の電極数が、例えば1000個や2000個のように多数である場合、対応する複数のプローブ針50及び複数の第二伝送線路62の数も多くなる。この場合、ビルドアップ基板40上面において多数の第二伝送線路62を外側方向に放射状に広げて配置することは困難である。エポキシ材を積層して多層のビルドアップ基板40を形成すると、ある配線層において複数の第二伝送線路62の一部だけを外側方向に放射状に広げ、残りの第二伝送線路62を他の配線層において外側方向に放射状に広げることができる。本実施形態においては、2枚のエポキシ材を重ね合わせて2層の配線層を形成している。

【0028】ビルドアップ基板40には複数の第二伝送線路62a、bと複数の第三伝送線路64a、bとが設けられる。複数の第二伝送線路62a、bは、第一配線層（下側のエポキシ基板の上面）に設けられる。複数の第二伝送線路62a、bの各々の一端には、第三パッド58a、bが設けられる。複数の第二伝送線路62a、bの各々の他端には、複数の第一ビア72a、bが設けられる。複数の第二伝送線路62a、bは、複数の第一ビア72a、bを通じて複数の第二パッド54a、bに接合される。グラウンド線は複数の第二伝送線路62a、bの近傍に設けられる。

【0029】複数の第三伝送線路64a、bは、第二配線層（上側のエポキシ基板の上面）に設けられる。複数の第三伝送線路64a、bの各々の一端には、第四パッド59a、bが設けられる。複数の第三伝送線路64a、bの各々の他端には、複数の第二ビア74a、bが設けられる。複数の第三伝送線路64a、bは、複数の第二ビア74a、bを通じて複数の第三パッド58a、bに接合される。第四パッド59a、bの上には複数のプローブ針50a、bが形成される。

【0030】図5は、第2実施形態におけるビルドアップ基板40の拡大平面図である。（a）はビルドアップ基板40の第二配線層（基板上面部42）を示す。プローブ針50c、d、e、f、gはそれぞれ第四パッド59c、d、e、f、gに接合される。プローブ針50c、d、e、f、gのうちプローブ針50d、e、fは、第三伝送線路64d、e、fを電気部品の電極に電氣的に接続する。プローブ針50c、gは、グラウンド線66c、gを電気部品のグラウンドに電氣的に接続する。第三伝送線路64d、e、fは、第二ビア74d、e、fを通して第一配線層に通ずる。グラウンド線66c、g

は第二ビア74c、gを通して第一配線層に通ずる。

【0031】図5（b）はビルドアップ基板40の第一配線層を示す。第二伝送線路62d、e、fの一端に設けられた第三パッド58d、e、f上の接合面73d、e、fには、それぞれ第二配線層に設けられた第二ビア74d、e、fが接合される。第二伝送線路62d、e、fは、第三パッド58d、e、fから外側方向へ放射状に広がる。第一配線層において、第二伝送線路62d、e、fを設けた表面以外の部分には、グラウンドとなるグラウンド層44を設ける。グラウンド層44の接合面73c、gには、第二配線層に設けられた第二ビア74c、gが接合される。

【0032】グラウンド層44には図示しないビアが設けられ、プリント基板30のグラウンドに接合する。これにより、プリント基板30及びビルドアップ基板40のインピーダンス整合が取られる。さらに、グラウンド層44を設けているので、第二伝送線路62のインダクタンスを小さくできる。従って、信号の信頼性を高めることができ、また、電源ノイズを減少させることができる。

【0033】本実施形態においては、エポキシ材を2枚重ね合わせているが、3枚以上重ね合わせてもよい。積層数を増やせば配線を設けるスペースをより広げることができる。一方、周囲にグラウンド層を設けていない配線層に長い伝送線路を並行させる場合、伝送線路間のクロストークが高くなりやすい。このため、クロストークを低減させるために伝送線路間にグラウンド線を設けることが望ましい。例えば、ビルドアップ基板40を多層構造にする場合、以下の方法を採用することができる。第一配線層にはグラウンド層を設けており、第一配線層の上に設けた第二配線層において複数の長い伝送線路を設ける。伝送線路の近傍にはグラウンド層を設けていない。このような場合、伝送線路間にグラウンド線を設け、グラウンド線の両端には第一配線層のグラウンド層に接合するビアをそれぞれ設ける。これにより、伝送線路間のクロストークが低減されるとともに、第一及び第二配線層間のインピーダンス整合が取られる。

【0034】図6は、プローブカードの製造過程を示す断面図である。プリント基板30はガラスエポキシを積層して形成される。図示するプリント基板30はプローブカード製造過程における加工前のプリント基板30である。加工前のプリント基板30は、扁平部32と扁平部32の上面中央に設けられた中央凸部34と中央凸部34から所定の距離を隔てて扁平部32の上面外周側に設けられた外周凸部36とを有する。

【0035】まず、プリント基板30に以下の方法で複数の第一伝送線路60a、bを設ける。最初に、プリント基板30の所定の位置に複数のスルーホール70a、bを設ける。次に、プリント基板30の下面に複数の第一伝送線路60a、bを設ける。次に、複数の第一伝送線路60a、bの一端（プリント基板30下面側の端

部)に複数の第一パッド52a、bを設け、複数の第一伝送線路60a、bの他端(プリント基板30上面側の端部)に複数の第二パッド54a、bを設ける。

【0036】プリント基板30に複数の第一伝送線路60a、bを設けた後、別途用意したフィルム状のエポキシ材の所定位置にレーザ加工等により複数の第一ビア72a、b用の孔を設ける。

【0037】エポキシ材に複数の第一ビア72a、b用の孔を設けた後、孔が設けられたエポキシ材をプリント基板30の上面に重ね合わせ、重ね合わせたエポキシ材をプリント基板30の中央凸部34上面及び外周凸部36上面に接着剤により張着する。複数の第一ビア72a、b用の孔は、複数の第二パッド54a、bの上方に位置する。

【0038】ビルドアップ基板40をプリント基板30の上面に張着した後、ビルドアップ基板40の上面にメッキする。複数の第一ビア72a、b用の孔の内側面及び開口底面がメッキされることにより複数の第一ビア72a、bが形成される。さらに、エッチングすることにより複数の第二伝送線路62a、bを設ける。

【0039】なお、エポキシ材を複数枚重ねてビルドアップ基板40を形成させる場合は、複数の第二伝送線路62a、bを設けた第一配線層の上に、複数の第二ビア74a、b用の孔を設けたエポキシ材をさらに張着する。そして、張着したエポキシ材の上面にメッキすると、複数の第二ビア74a、b用の孔の内側面及び開口底面がメッキされることにより複数の第二ビア74a、bが形成される。さらに、エッチングすることにより複数の第三伝送線路64a、bを設ける。複数の第三伝送線路64a、bのビルドアップ基板40上面側の端部には、複数の第四パッド59a、bを設ける。

【0040】ビルドアップ基板40に複数の第二伝送線路62a、bを設けた後、図におけるA-A'面とB-B'面でビルドアップ基板40を切断する。即ち、プリント基板30の中央凸部34の外周に沿ってビルドアップ基板40を切断する。次に、C-C'面とD-D'面とでプリント基板30を切断する。即ち、プリント基板30の外周凸部36の内周に沿ってプリント基板30を切断する。これらの切断により、本実施形態のプロブカードは、扁平部32と扁平部32の上面中央に設けられた中央凸部34とを有し、中央凸部34の上面にビルドアップ基板40が張着された構成となる。

【0041】プリント基板30及びビルドアップ基板40を切断した後、複数の第三パッド58a、bの上面に複数のプロブ針50a、bを形成させる。本実施形態における複数のプロブ針50a、bは、以下の方法により形成させる。まず、プロブ針固着用のボンディングマシン100を用いて、第三パッド58a、bにワイヤの先端部を固着する。次に、ワイヤにおける先端部の上部を加熱してE-E'面で切断する。複数の第三パッ

ド58a、bに残されたワイヤは所定の長さのプロブ針50a、bとなる。本実施形態におけるプロブ針50は、長さ約2mmの微小針である。

【0042】本実施形態によれば、ビルドアップ基板40の上面において高い位置精度で複数のプロブ針50a、bを設けることができるので、複数のプロブ針50a、bを手動で位置調整する必要がない。従って、プロブ針50を第三パッド58の上にボンディングマシン100を用いて自動的に形成させることができる。また、複数のプロブ針50a、bを複数の第三パッド58a、bの上にボンディングマシン100を用いて同時に形成させることができる。

【0043】以上のように、本実施形態においては、フィルム状のエポキシ基板であるビルドアップ基板40を、平坦度と機械的強度とが高いガラスエポキシ基板であるプリント基板30の上面に張着している。これにより、表面の平坦度と機械的強度とが高いプロブカードを作成することができる。

【0044】また、本実施形態においては、複数のプロブ針50a、bとしてS形状の微小針を用いている。S形状の微小針は、湾曲部により上下方向の弾力が得られる。また、S形状の微小針は、第三パッド58に接合する一端と電気部品の電極に接触する他端とが水平方向にずれているため、電極に押圧されたプロブ針50が電気部品の電極をスクラブすることとなって接触性が高い。

【0045】また、本実施形態においては、プリント基板30の上面にビルドアップ基板40を設けるので、複数のプロブ針50a、bを接合する際の針位置精度が高い。従って、微小針をはじめとして様々な種類の針を複数のプロブ針50a、bとして用いることができる。さらに、エポキシ基板は安価なため、低コストで基板上の針位置精度を高めることができる。

【0046】また、本実施形態においては、複数のプロブ針50a、bとして微小針を用いている。従って、非伝送線路の長さを短くでき、信号の信頼性を高めることができる。さらに、プリント基板30に設けられるコンデンサからプロブテスト対象の電気部品までの距離が短縮されるので、電源ノイズを減少させることができる。

【0047】また、本実施形態によれば、ビルドアップ基板40の上面において高い位置精度で複数の第三パッド58a、b及び複数のプロブ針50a、bを設けることができるので、複数の第三パッド58a、bの間隔及びピッチ、並びに、複数のプロブ針50a、bの間隔及びピッチを狭くすることができる。

【0048】また、本実施形態によれば、ビルドアップ基板40の上面において高い位置精度でプロブ針50を設けることができるので、プロブ針50を手動で位置調整する必要がない。従って、プロブ針50を第三

パッド58の上にボンディングマシン100を用いて自動的に、かつ、複数同時に形成させることができる。

【0049】以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることができることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。

【発明の効果】上記説明から明らかなように、本発明によればプリント基板上にビルドアップ基板を設けることにより、プローブ針の位置精度を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来のプローブカードを示す断面図である。

【図2】第一の実施形態におけるプローブカードの断面図である。

【図3】第一の実施形態におけるプローブカードの平面図である。

【図4】第二の実施形態におけるプローブカードの断面図である。

【図5】第二の実施形態におけるビルドアップ基板40の拡大平面図である。

【図6】第一実施形態におけるプローブカードの製造過程を示す断面図である。

【符号の説明】

10 プリント基板

20a、b プローブ針

22a、b 伝送線路

24a、b 半田付け部

26a、b 固定用樹脂部

28a、b 固定台

30 プリント基板

32 扁平部

34 中央凸部

36 外周凸部

40 ビルドアップ基板

42 基板上面部

44 グランド層

50a～g プローブ針

52a、b 第一パッド

54a、b 第二パッド

58a、b、d、e、f 第三パッド

59a～g 第四パッド

60a、b 第一伝送線路

62a、b、d、e、f 第二伝送線路

64a、b、d、e、f 第三伝送線路

66c、g グランド線

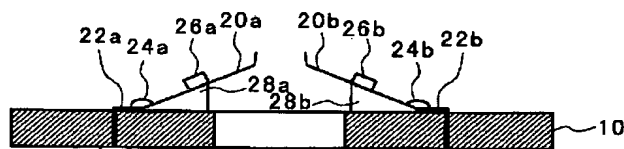
70a、b スルーホール

72a、b、d、e、f 第一ビア

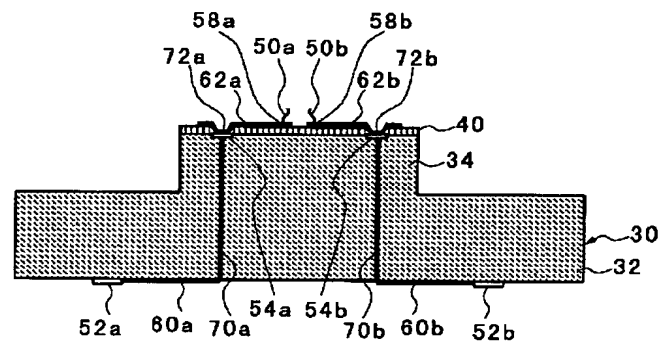
74a～g 第二ビア

100 ボンディングマシン

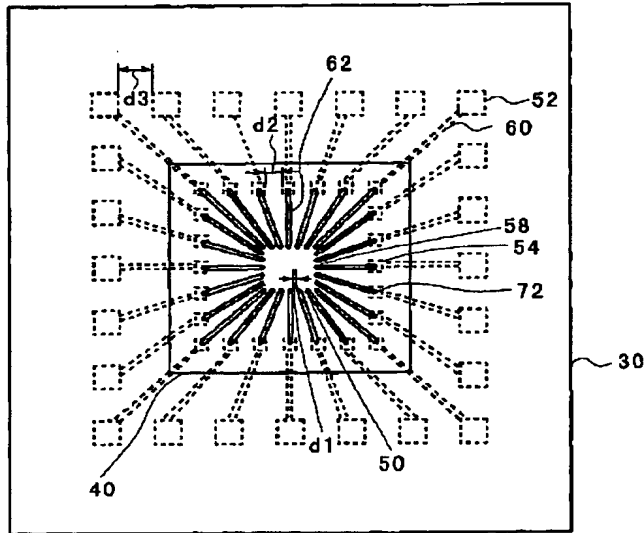
【図1】



【図2】

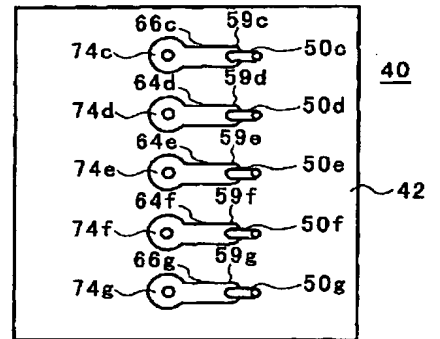


【図3】

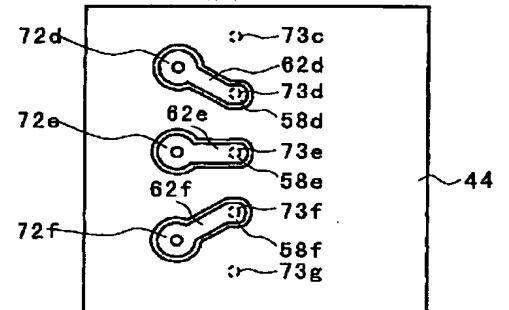


【図5】

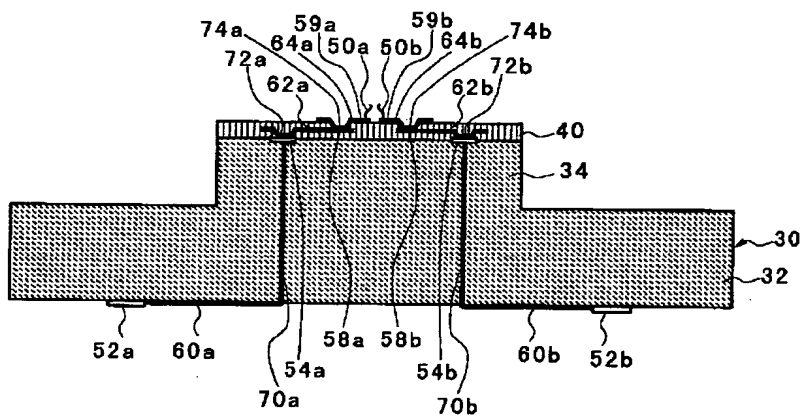
(e) 第二配線層



(b) 第一配線層



【図4】



【図6】

